

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2023-005

## 金发科技股份有限公司

### 第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年2月24日以电子邮件和企业微信方式发出。会议于2023年3月1日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司2023年度拟向中国工商银行申请总额不超过27.09亿元人民币综合授信额度，授信有效期至新一年度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内授权董事长代表公司签署或签章与银行融资有关的合同或协议，产品品种以具体签署的业务合同或协议为准（含汇率避险产品）。在办理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日